FN- DIALOG(R) File 347: JAPIO

CZ-(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

TI- NITRIDE SEMICONDUCTOR LASER ELEMENT

PN-10-012969 -JP 10012969 A-

PD- January 16, 1998 (19980116)

AU- NAGAHAMA SHINICHI; NAKAMURA SHUJI

PA- NICHIA CHEM IND LTD [424878] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

AN- 08-157812 -JP 96157812-

AN- 08-157812 -JP 96157812-

AD-June 19, 1996 (19960619)

IC--6- H01S-003/18; H01L-033/00

CL-42.2 (ELECTRONICS - Solid State Components)

KW-R002 (LASERS); R095 (ELECTRONIC MATERIALS -- Semiconductor Mixed Crystals); R116 (ELECTRONIC MATERIALS - Light Emitting Diodes, LED)

AB- PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the threshold current of a nitride semiconductor laser element, by doping n-type and/or p-type impurities in its active layer, and further, by forming a plurality of light emission peaks different from those of the longitudinal mode in its light emission spectrum.

SOLUTION: On a substrate 1 of a nitride semiconductor laser element, a buffer layer 2, an n-type contact layer 3, an n-type clad layer 4 and an active layer 5 having a multiple quantum well structure doped by impurities are formed. The well layer is not subjected to the growth accompanied by a uniform film thickness to be brought into the superimposing state of many irregular layers. This is caused by the reason that the irregularity originates from the concurrent generations of the large and small regions of its In composition. InGaN is the material hard to be subjected to the growth of a mixed crystal, and is the easy material to generate the unhomogeneous regions of the In composition, the local existences of electrons and holes, and the many light emission peaks caused by exciton light emission. When n-type and/or p-type impurities are doped in its active layer 5, the excitons existed locally in its active layer 5 are localized at further deeper impurity levels, the effect of exciton light emission is made remarkable to make its threshold current reducible.

	•
	•

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平10-12969

(43)公開日 平成10年(1998)1月16日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

H01S 3/18 H01L 33/00

H01S 3/18 H01L 33/00

C

## 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)

(21)出顯番号

特願平8-157812

(71)出廣人 000226057

日亜化学工業株式会社

(22)出顧日

平成8年(1996)6月19日

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72)発明者 長濱 慎一

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

学工業株式会社内

(72)発明者 中村 修二

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

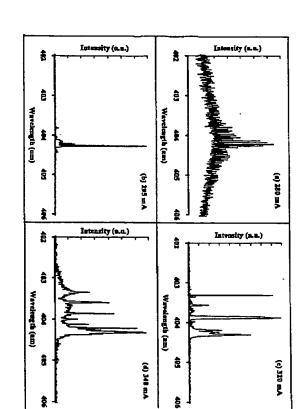
学工業株式会社内

# (54) 【発明の名称】 窒化物半導体レーザ素子

#### (57)【要約】

【目的】 窒化物半導体よりなるレーザ素子の発光出力 を高め、さらに閾値電流を小さくして、室温での連続発 振を目指す。

【構成】 インジウムを含む窒化物半導体よりなる井戸 層と、井戸層よりもバンドギャップが大きい窒化物半導 体よりなる障壁層とが積層されてなる多重量子井戸構造 の活性層を有する窒化物半導体レーザ素子において、前 プされており、さらに前記レーザ素子の発光スペクトル 中には縦モードの発光ピークとは異なる複数の発光ピー クを有する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 インジウムを含む窒化物半導体よりなる井戸層と、井戸層よりもバンドギャップが大きい窒化物半導体よりなる障壁層とが積層されてなる多重量子井戸構造の活性層を有する窒化物半導体レーザ素子において、前記活性層中にはn型不純物及び/又はp型不純物がドープされており、さらに前記レーザ素子の発光スペクトル中には縦モードの発光ピークとは異なる複数の発光ピークを有することを特徴とする窒化物半導体レーザ素子。

【請求項2】 前記レーザ素子の発光スペクトルの発光 ピークが、 $1 meV \sim 100 meV$ 間隔の範囲内にある ことを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体レーザ 素子。

【請求項3】 前記活性層にはn型不純物がドープされており、 $1 \times 10^{18}/cm^3 \sim 1 \times 10^{22}/cm^3$ の濃度でドープされていることを特徴とする請求項1または2に記載の窒化物半導体レーザ素子。

【請求項4】 前記活性層にはp型不純物がドープされており、 $1 \times 10^{17}/cm^3 \sim 1 \times 10^{22}/cm^3$ の濃度でド 20一プされていることを特徴とする請求項1乃至3の内のいずれか1項に記載の窒化物半導体レーザ素子。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は窒化物半導体( $In_{xA1_{y}Ga_{1-x-y}N}$ 、 $0 \le X$ 、 $0 \le Y$ 、 $X+Y \le 1$ )よりなるレーザ素子に関する。

#### [0002]

【従来の技術】活性層にSiがドープされたレーザ素子が、特開平7-297494号公報に記載されている。この公報にはGaNよりなる膜厚の厚い活性層にSiをドープして閾値電流を低下させることが開示されている。

【0003】しかし、前記公報のように、単一層の膜厚 が例えば0.1 µm以上もある厚膜の活性層を有する素 子構造では出力が弱く、レーザ発振させるのは非常に困 難である。また活性層を単一膜厚が100オングストー ム近辺にある井戸層と障壁層とを積層した多重量子井戸 構造の活性層を有するレーザ素子が、例えば特開平8-64909号公報に記載されている。この公報には、井 40 戸層にZnがドープされた多重量子井戸構造の活性層を 有するレーザ素子が記載されており、井戸層に極微量の Znをドープすることにより、価電子帯近くにアクセプ ター的な不純物準位を形成して、閾値電流を低下させる ことが示されている。さらにまた、特開平6-2682 57号公報にはInxGa1-xNよりなる井戸層と、In yGa1-yNよりなる障壁層とを積層した多重量子井戸構 造の活性層を有する発光素子が示されており、さらにこ の公報には活性層にn型不純物、またはp型不純物をド ープしても良いことが記載されている。

2

【0004】このように活性層にn型、p型不純物をドープして、バンドギャップ内に不純物準位を形成することにより、発光素子の発光出力を高めたり、レーザ素子の閾値電流を低下させることが知られている。

#### [0005]

【0006】しかしながら、前記窒化物半導体レーザは 未だパルス発振でしかなく、しかも閾値電流は1~2A もある。窒化物半導体で連続発振させるためには、閾値 電流をさらに低下させる必要がある。

【0007】従って、本発明の目的とするところは、窒化物半導体よりなるレーザ素子の発光出力を高め、さらに閾値電流を小さくして、室温での連続発振を目指すことにある。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明のレーザ素子は、インジウムを含む窒化物半導体よりなる井戸層と、井戸層よりもバンドギャップが大きい窒化物半導体よりなる障壁層とが積層されてなる多重量子井戸構造の活性層を有する窒化物半導体レーザ素子において、前記活性層中にはn型不純物及び/又はp型不純物がドープされており、さらに前記レーザ素子の発光スペクトル中には縦モードの発光ビークとは異なる複数の発光ビークを有することを特徴とする。

【0009】さらに本発明のレーザ素子は、前記レーザ素子の発光スペクトルの発光ピークは、 $1 meV \sim 100 meV$ 間隔の範囲内にあることを特徴とする。なお、本発明において、必ずしも隣り合った全ての発光ピークの間隔が前記範囲の間にあることを指すものではない。【0010】また、活性層にはn型不純物がドープされており、そのn型不純物が $1 \times 10^{18}/cm^3 \sim 1 \times 10^{22}/cm^3$ の濃度でドープされていることが望ましく、さらに好ましくは、n型不純物は少なくとも井戸層にドープされていることが望ましい。

【0011】また、活性層にはp型不純物がドープされており、そのp型不純物が $1\times10^{17}$ / $cm^3\sim1\times10^{22}$ / $cm^3$ の濃度でドープされていることが望ましく、さらに好ましくは、p型不純物は少なくとも井戸層にドープされていることが望ましい。

## [0012]

【発明の実施の形態】図1は本発明の一実施例に係るレーザ素子の構造を示す模式的な断面図である。基本的な構造としては、基板1の上に、バッファ層2、n型コン タクト層3、n型クラッド層4、不純物がドープされた

多重量子井戸構造を有する活性層 5、第1のp型層 6、第2のp型層 7、第3のp型層 8、p型コンタクト層 9 が順に積層された電極ストライプ型の構造を有しており、n型コンタクト層にはストライプ状の負電極、p型コンタクト層には正電極が設けられている。

【0013】このレーザ素子を各パルス電流を流した際のスペクトルを図3に示す。図3において(a) は280mA(閾値直後)、(b) は295mA、(c) は320mA、(d) は340mAでの発光スペクトルを示している。(b)、(c)、(d) は発振時のスペクトルを示している。

【0014】(a)は発振直後のスペクトルを示し、こ の状態ではおよそ404.2nm付近にある主発光ピー クの前後に小さな発光ビークが多数(ファブリペローモ ード) 出現してレーザ発振直後の状態であることが分か る。これがいわゆる縦モードのスペクトルである。電流 値を上げると(b)に示すように、そのスペクトルがシ ングルモードとなって404.2nm付近のレーザ発振 を示す。次からが本発明の特徴であり、さらに電流を増 加させると、(c)に示すように、403.3nm (3.075eV), 403.6nm (3.072e V) \ 403. 9nm (3. 070eV) \ 404. 2 nm (3.068eV), 404.4nm (3.066 e V) というように、主発光ピークの他に、強度の大き な発光ピークが1meV~100meVの間隔で不規則 に出現する。さらに (d) では前記ピークの他に、また 新たなピークがはっきりと出現しており。これらのスペ クトル間隔は一定ではなく明らかに縦モードのスペクト ルと異なる。

【0015】一般に、半導体レーザの場合、レーザ発振 30 すると、レーザ光の縦モードによる小さな発光ピークが主発光ピークの前後に多数出現する。この場合の発光スペクトルは、ほぼ等間隔の発光ピークよりなっている。赤色半導体レーザでは、その発光ピークの間隔はおよそ 0.2 nmである。青色半導体レーザではおよそ0.0 5 nm (1 me V) 以下である(但し、青色半導体レーザの縦モードは共振器長が600μmにおいて、本出願人により初めて計測された。)。つまり、図3(a)、

(b) の状態では通常のレーザ素子の挙動を示している。しかし、本発明のレーザ素子の場合、(c)、

(d) に示すように、明らかに従来のレーザ素子の縦モードによる発光ピークとは異なった等間隔でないピークが多数出現している。これは図3の電流値による各スペクトルを比較しても分かる。本発明のレーザ素子では、このような発光スペクトルが出現することにより、出力が高くなる。

【0016】なぜ、このようなピークが発生するとレー ザ素子の出力が高くなるのかは定かではないが、例えば 次のようなことが考えられる。活性層が量子井戸構造の 場合 井戸層の膜厚は100オングストローム以下、好

ましくは70オングストローム以下、最も好ましくは5 0オングストローム以下に調整される。一方、障壁層も 150オングストローム以下、好ましくは100オング ストローム以下に調整される。本発明の発光索子では、 このような単一膜厚が数十オングストロームの薄膜を積 層した場合、井戸層、障壁層共、均一な膜厚で成長して おらず、凹凸のある層が幾重にも重なり合った状態とな っている。図2は図1のレーザ素子において活性層5と クラッド層との界面の状態を拡大して示す模式的な断面 図である。図2に示すように、このような凹凸のある活 性層を、活性層よりもバンドギャップの大きいクラッド 層で挟むダブルヘテロ構造を実現すると、活性層に注入 された電子とホールとが、凹部にも閉じ込められるよう になって、クラッド層の縦方向と共に縦横の両方向に閉 じ込められる。このため、キャリアが約10~70オン グストローム凹凸差がある3次元のInGaNよりなる 量子箱、あるいは量子ディスクに閉じ込められたように なって、従来の量子井戸構造とは違った、量子効果が出 現する。従って、多数の量子準位に基づく発光が室温で も観測されるようになり、発光スペクトルの1meV~ 100meVの間隔で多数の発光ピークが観測される。 また、他の理由としては、三次元のInGaNよりなる 小さな量子箱にキャリアが閉じ込められるので、エキシ トン効果が顕著に現れてきて多数の発光ピークが観測さ れる。

【0017】また、このようにInGaN井戸層に多数 の凹凸が発生する理由の一つとして、In組成の面内不 均一が考えられる。即ち、単一井戸層内において、In 組成の大きい領域と、少ない領域とができるために、井 戸層表面に多数の凹凸が発生するのである。InGaN は混晶を成長させにくい材料であり、InNとGaNと が相分離する傾向にある。このためIn組成の不均一な 領域ができる。そして、このIn組成の高い領域に電子 と正孔とが局在して、エキシトン発光、あるいはバイエ キシトン発光して、レーザの出力が向上し、多数のピー クができる。特にレーザ素子ではこのバイエキシトンレ ーザ発振することにより、量子ディスク、量子箱と同等 になって多数のピークが出現し、この多数のピークによ りレーザ素子の閾値が下がり、出力が向上する。なおエ 40 キシトンとは電子と正孔とが弱いクーロン力でくっつい てペアになったものである。

【0018】さらに、活性層中に n型不純物及び/又は p型不純物をドープすることにより、閾値電流を低下させることができる。これらの不純物をドープすることにより、活性層の I n組成の多い領域に局在化しているエキシトンが、今度はそれよりもさらに深い不純物の準位に局在化するようになって、エキシトン発光の効果が顕著となることにより、閾値の低下が起きる。

【0019】本発明のレーザ素子の活性層について述べたことを、図6のエネルギーバンド図でわかりやすく示

{

す。図6Aは多重量子井戸構造の活性層のエネルギーバ ンドを示しており、図6Bは、図6Aの単一井戸層のエ ネルギーバンドを拡大して示すものである。前記したよ うに、井戸層においてIn組成の面内不均一があるとい うことは、Bに示すように単一のInGaN井戸層幅に バンドギャップの異なるInGaN領域が存在する。従 って、伝導帯にある電子は一度、In組成の大きいIn GaN領域に落ちて、そこから価電子帯にある正孔と再 結合することによりhvのエネルギーを放出する。この ことは、電子と正孔とが井戸層幅のIn組成の多い領域 に局在化して、局在エキシトンを形成し、レーザの閾値 の低下を助ける。閾値が下がり、出力が高くなるのはこ の局在エキシトンの効果によるものである。さらに、こ の井戸層にSi等のn型不純物、Ζn等のp型不純物を ドープすることにより、伝導帯と価電子帯との間にさら に不純物レベルの準位ができる。図6BではSiと、Z nとでもってその準位を示している。不純物をドープす ると不純物レベルのエネルギー準位が形成される。その ため電子はより深い準位へ落ち、正孔はp型不純物のレ ベルに移動して、そこで電子と正孔とが再結合して、h 20 ν'のより小さいエネルギーを放出する。このことは電 子と正孔とがさらに局在化することを意味し、この局在 したエキシトン効果によりレーザの閾値が下がるのであ る。多数のピークが出現するのは、この局在エキシトン に加えて、三次元的に閉じ込められた量子箱の効果によ り多数の量子準位間の発光が出てくるからである。

【0020】n型不純物には、例えばSi、Ge、S n、Se、Sを挙げることができる。p型不純物には、 例えばZn、Cd、Mg、Be、Ca等を挙げることが できる。これらの不純物を活性層中、特に好ましくは井 30 戸層中にドープすることにより、量子準位間に、不純物 レベルの発光を起こさせ、バンド間のエネルギー準位を 小さくして、閾値を低下させることができる。なお、n 型不純物、p型不純物両方をドープしてもよいことは言 うまでもない。

【0021】特に好ましくはn型不純物、中でもSi、 Geをドープすることにより、発光強度を強めると共 に、閾値電流を低下させることができる。図4は井戸層 にドープしたSi濃度と、閾値電流の低下率の割合を示 す図である。具体的には平均膜厚30オングストローム 40 の In GaNよりなる井戸層と、平均膜厚70オングス トローム障壁とを5層積層した多重量子井戸構造の活性 層を有するレーザ素子において、前記井戸層中にSiを ドープした際のレーザ素子の閾値の低下の割合を示して おり、図に示す各点は実際のSi濃度を示している。こ の図に示すようにSiをドープすることにより、閾値電 流を最大で50%近く低下させることができる。従っ て、好ましいSi濃度は、1×10<sup>18</sup>/cm<sup>3</sup>~1×10 <sup>22</sup>/cm<sup>3</sup>の範囲にあり、さらに好ましくは5×10<sup>18</sup>/c m<sup>3</sup>~2×10<sup>21</sup>/cm<sup>3</sup>、最も好ましくは1×10<sup>19</sup>/cm<sup>3</sup> 50

~1×10<sup>21</sup>/cm³である。なおこの図はSiについて 示したものであるが、他のn型不純物、Ge、Sn等に 対しても同様の傾向があることを確認した。

【0022】図5は井戸層にドープしたMg濃度と、閾 値電流の低下率の割合を示す図である。これも同じく平 均膜厚30オングストロームのInGaNよりなる井戸 層と、平均膜厚70オングストローム障壁とを5層積層 した多重量子井戸構造の活性層を有するレーザ素子にお いて、前記井戸層中にMgをドープした際のレーザ素子 の閾値の低下の割合を示しており、図に示す各点は実際 のMg濃度を示している。この図に示すように、Mgを ドープすることにより、閾値電流を25%近く低下させ ることができる。好ましいMg濃度は、 $1 \times 10^{17}$ /cm 3~1×10<sup>22</sup>/cm<sup>3</sup>の範囲にあり、さらに好ましくは1 ×10<sup>18</sup>/cm<sup>3</sup>~2×10<sup>21</sup>/cm<sup>3</sup>、最も好ましくは1× 10<sup>18</sup>/cm³~1×10<sup>21</sup>/cm³である。なお、この図は Mgについて示したものであるが、他のp型不純物、Z n、Cd、Be等に対しても同様の傾向があることを確 認した。

#### [0023]

【実施例】以下、MOVPE法を用いて、図1に示す構 造のレーザ素子を得る方法を説明する。図1は本発明の レーザ素子の一構造を示すものであって、本発明のレー ザ素子はこの構造に限定されるものではない。なお本発 明において示す InxGa1-xN、AlyGa1-yN等の一 般式は、単に窒化物半導体の組成式を示しているに過ぎ ず、異なる層が同一の式で示されていても、それらの層 が同一の組成を示すものでは決してない。

【0024】 [実施例1] サファイアのA面を主面とす る基板1を用意し、この基板1をMOVPE装置の反応 容器内に設置した後、原料ガスにTMG(トリメチルガ リウム)と、アンモニアを用い、温度500℃でサファ イア基板1の表面にGaNよりなるバッファ層2を20 0オングストロームの膜厚で成長させる。基板1にはA 面の他にC面、R面等の面方位を有するサファイアが使 用でき、サファイアの他、スピネル111面(MgA1 204)、SiC、MgO、Si、ZnO、GaN等の単 結晶よりなる、公知の基板が用いられる。バッファ層2 は基板と窒化物半導体との格子不整合を緩和するために 設けられ、通常、GaN、A1N、A1GaN等が10 00オングストローム以下の膜厚で成長されるが、窒化 物半導体と格子定数の近い基板、格子整合した基板を用 いる場合、成長方法、成長条件等の要因によっては成長 されないこともあるので、省略することもできる。但 し、サファイア、スピネルのように、窒化物半導体と格 子定数が異なる基板を用いる場合、特開平4-2970 23号公報に記載されるように、200℃以上、900 ℃以下の温度でバッファ層2を成長させると、次に高温 で成長させる窒化物半導体層の結晶性が飛躍的に良くな

る。

層5を成長させる。

8

【0025】続いて温度を1050℃に上げ、原料ガスにTMG、TMA(トリメチルアルミニウム)、アンモニア、ドナー不純物としてSiH (シラン)ガスを用いて、SiドープA 10.3G a0.7Nよりなるn型コンタクト層 3 を4  $\mu$ mの膜厚で成長させる。

【0026】n型コンタクト層3は光閉じ込め層として も作用する。n型コンタクト層3をA1とGaとを含む n型窒化物半導体、好ましくはn型AlYGa1-YN(0 <Y<1)とすることにより、活性層との屈折率差が大 きくでき、光閉じ込め層としてのクラッド層、及び電流 10 を注入するコンタクト層として作用する。さらに、この コンタクト層をAlyGai-yNとすることにより、活性 層の発光をn型コンタクト層内で広がりにくくできるの で、閾値が低下する。n型コンタクト層3をAlyGa 1-YNとする場合、基板側のA1混晶比が小さく、活性 層側のA1混晶比が大きい構造、即ち組成傾斜構造とす ることが望ましい。前記構造とすることにより、結晶性 の良いn型コンタクト層が得られるので、結晶性の良い n型コンタクト層の上に積層する窒化物半導体の結晶性 も良くなるため、素子全体の結晶性が良くなり、ひいて 20 は閾値の低下、索子の信頼性が格段に向上する。また活 性層側のA1混晶比が大きいために、活性層との屈折率 差も大きくなり光閉じ込め層として有効に作用する。ま た、このn型コンタクト層3をGaNとしてもよい。G aNの場合、n電極とのオーミック特性については非常 に優れている。コンタクト層をGaNとすると、GaN コンタクト層と、活性層との間にA1GaNよりなる光 閉じ込め層を設ける必要がある。このn型コンタクト層 3の膜厚は $0.1\mu$ m以上、 $5\mu$ m以下に調整すること が望ましい。0.1μm以下であると、光閉じ込め層と して作用しにくく、また、電極を同一面側に設ける場合 に、精密なエッチングレートの制御をせねばならないの で不利である。一方、5μmよりも厚いと、結晶中にク ラックが入りやすくなる傾向にある。

【0027】続いて、温度を1050℃に保持し、原料ガスにTMG、アンモニア、シランガスを用いて、Siドープn型GaNよりなるn型クラッド層4を500オングストロームの膜厚で成長させる。

【0028】このn型クラッド層 4はn層側の光ガイド層、および活性層に InGaNを成長させる際のバッファ層として作用し、n型GaNの他、n型InGaNを成長させることもできる。バッファ層と成長させる場合には $0.05\mu$ m以下の膜厚で成長させることが望ましい。また、前記のようにコンタクト層 2をGaNで成長させた場合、このn型クラッド層 4は、光閉じ込め層として作用させるためにA1GaNで成長させる必要がある。A1GaN層の場合、膜厚は $0.01\mu$ m $\sim 0.5\mu$ mの膜厚で成長させることが望ましい。 $0.01\mu$ m より薄いと光閉じ込め層として作用しにくく、 $0.5\mu$ mよりも厚いと結晶中にクラックが入りやすい傾向にあ

【0029】次に、温度を750℃にして、原料ガスに TMG、TMI (トリメチルインジウム)、アンモニア、不純物ガスとしてシランガスを用いてSieF-プした活性層5eK-プした活性層5eK-プしたIn0.2Ga0.8Nよりなる井戸層を25オングストロームの膜厚で成長させる。次にシランガスを止めて、TMIのモル比を変化させるのみで同一温度で、ノンドープIn0.01Ga0.95Nよりなる障壁層を50オングストロームの膜厚で成長させる。この操作を13回繰り返し、最後に井戸層を成長させ総膜厚 $0.1\mu$ のの多重量子井戸構造よりなる活性

【0030】活性層5は、少なくとも井戸層がInを含 む窒化物半導体を含む多重量子井戸構造とする。多重量 子井戸構造とは、井戸層と障壁層とを積層したものであ り、本発明の場合、井戸層がInを含む窒化物半導体で 構成されていれば、障壁層は井戸層よりもバンドギャッ プが大きければ特にInを含む必要はない。好ましく は、InxGa1-xN(0<X≦1)よりなる井戸層と、 Inx' Ga₁-x' N (0≦X'<1、X'<X) よりなる障壁 層とを積層した構造とする。三元混晶のInGaNは四 元混晶のものに比べて結晶性が良い物が得られるので、 発光出力が向上する。また障壁層は井戸層よりもバンド ギャップエネルギーを大きくして、井戸+障壁+井戸+ ・・・+障壁+井戸層(その逆でもよい。)となるよう に積層して多重量子井戸構造を構成する。井戸層の膜厚 は70オングストローム以下、さらに望ましくは50オ ングストローム以下に調整することが好ましい。また障 壁層の厚さも150オングストローム以下、さらに望ま しくは100オングストローム以下の厚さに調整するこ とが望ましい。井戸層が70オングストロームよりも厚 いか、または障壁層が150オングストロームよりも厚 いと、レーザ素子の出力が低下する傾向にある。このよ うに活性層をInGaNを積層したMQWとすると、量 子準位間発光で約365mm~660mm間での高出力 なLDを実現することができる。特に好ましい態様とし て、両方の層をInGaNとすると、InGaNは、G aN、AlGaN結晶に比べて結晶が柔らかい。そのた め第1のp型層であるA1GaNの厚さを厚くできるの でレーザ発振が実現できる。またn型不純物は本実施例 のように井戸層にドープしてもよいし、また障壁層にド ープしてもよく、さらに井戸層、障壁層両方にドープし てもよい。

【0031】活性層5の膜厚は、n型コンタクト層3を  $A1_{Y}Ga_{1-Y}N$ とした場合、200オングストローム以上、さらに好ましくは300オングストローム以上の膜厚で成長させることが望ましい。なぜなら、MQWよりなる活性層を厚く成長させることにより、活性層の最外層近辺が光ガイド層として作用する。つまり、n型コン

40

10

【0033】第1のp型層6はA1を含むp型の窒化物 10 半導体で構成し、好ましくは三元混晶若しくは二元混晶のA1 $_{Y}$ Ga $_{1-Y}$ N (0 $_{Y}$  $_{S}$ 1)を成長させることが望ましい。さらに、このA1GaNは後に述べる第3のp型層8よりも膜厚を薄く形成することが望ましく、好ましくは10オングストローム以上、0.5 $_{\mu}$ m以下に調整する。この第1のp型層6を活性層5に接して形成することにより、素子の出力が格段に向上する。これは、第1のp型層6成長時に、活性層のInGaNが分解するのを抑える作用があるためと推察されるが、詳しいことは不明である。第1のp型層6は好ましく10オング 20ストローム $_{S}$ 0.5 $_{\mu}$ m以下の膜厚で成長させることが望ましいが、省略することもできる。

【0034】次に、温度を1050℃にし、TMG、アンモニア、Cp2Mgを用いて、Mgドープp型GaNよりなる第2のp型層7を500オングストロームの膜厚で成長させる。

【0035】この第2のp型層7はp層側の光ガイド層若しくはバッファ層として作用し、好ましくは二元混晶または三元混晶の $In_YGa_{1-Y}N$ (0 $\leq$ Y<1)を成長させる。第2のp型層7は、活性層の膜厚が薄い場合に成長させると光ガイド層として作用する。また第1のp型層6がA1GaN等よりなるので、この層がバッファ層のような作用をして、次に成長させる第3のp型層8をクラック無く結晶性良く成長できる。つまり、A1GaNの上に直接バンドギャップが大きいA1GaNを積層すると、後から成長させたバンドギャップが大きいA1GaNにクラックが入りやすくなるので、この第2のp型層7を介することによりクラックを入りにくくしている。第2のp型層7は、通常100オングストローム $\sim$ 0.5 $\mu$ m程度の膜厚で成長させることが望ましいが、省略することもできる。

【0036】次に、温度を1050℃に上げ、原料ガスに TMG、TMA、アンモニア、アクセプター不純物として Cp2Mgを用いて、MgドープA 10.3Ga0.7Nよりなる第3のp型層8を0.3 $\mu$ mの膜厚で成長させる。

【0037】第3のp型層8は、A1を含む窒化物半導体で構成し、好ましくは二元混晶または三元混晶のA1 <sub>y</sub>Ga<sub>1-y</sub>N (0<Y≦1)を成長させる。第3のp型層8は、光閉じ込め層として作用し、0.1 μm~1 μm 50

の膜厚で成長させることが望ましく、A1GaNのようなA1を含むp型窒化物半導体とすることにより、好ましく光閉じ込め層として作用する。この第3のp型層も活性層5をInを含む窒化物半導体としているために、成長可能となる。つまり、InGaNを含む活性層が緩衝層のような作用をするために、A1GaNを厚膜で成長させやすくなる。逆にA1を含む窒化物半導体層の上に、直接光閉じ込め層となるような厚膜で、A1を含む窒化物半導体を成長させることは難しい傾向にある。

【0038】続いて、1050℃でTMG、アンモニア、Cp2Mgを用い、Mgドープp型GaNよりなるp型コンタクト層9を0.5 $\mu$ mの膜厚で成長させる。【0039】p型コンタクト層9は電流を注入する層であり、p型の窒化物半導体(InxAlrGal-x-yN、0≦X、0≦Y、X+Y≦1)で構成することができ、特にInGaN、GaN、その中でもMgをドープしたp型GaNとすると、最もキャリア濃度の高いp型層が得られて、正電極と良好なオーミック接触が得られ、しきい値電流を低下させることができる。正電極の材料としてはNi、Pd、Ir、Rh、Pt、Ag、Au等の比較的仕事関数の高い金属又は合金がオーミックが得られやすい。

【0040】以上のようにして窒化物半導体を積層した ウェーハを反応容器から取り出し、図1に示すように最 上層のp型コンタクト層9より選択エッチングを行い、 n型コンタクト層3の表面を露出させ、露出したn型コ ンタクト層3と、p型コンタクト層9との表面にそれぞ れストライプ状の電極を形成した後、サファイア基板の R面からウェーハを劈開して、バー状にし、さらにスト ライプ状の電極に直交する方向にレーザの共振面を形成 し、共振器長は600µmとする。後は、常法に従い、 共振面に誘電体多層膜よりなる反射鏡を形成した後、ス トライプ状の電極に平行な位置でウェーハを分割してレ ーザチップとする。このレーザチップをヒートシンクに 設置し、順方向電流320mAのパルス発振を試みたと ころ、図3 (c) に示すような不規則な位置に発光ピー クを有するレーザ発振を示し、活性層に不純物をドープ していないレーザ素子に比較して、閾値電流は50%低 下し、出力は30%向上した。

【0041】 [実施例2] 実施例1の活性層を成長させる工程において、不純物ガスとしてシランガスの代わりにジエチルジンクを用いて、 $2 ne1 \times 10^{19}/cm^3$ の 濃度でドープした 1 n0.2 Ga0.8 N よりなる井戸層を2 5 オングストローム、ノンドープ1 n0.01 Ga0.95 N よりなる障壁層を5 0 オングストロームの膜厚で成長させて、同じく総膜厚 $0.1 \mu$ mの多重量子井戸構造よりなる活性層5 を成長させる他は、同様にして、共振器長 $6 00 \mu$ mのレーザ素子を得たところ、活性層に不純物をドープしていないレーザ素子に比較して、閾値電流は2 5 %低下し、出力は10 %向上した。

12

【0042】 [実施例3] 実施例1の活性層を成長させ る工程において、不純物ガスとしてシランガス、および ジエチルジンクを用いて、Siを1×10<sup>20</sup>/cm<sup>3</sup>、及 びZnを1×10<sup>18</sup>/cm³の濃度でドープしたIn0.2G a0.8Nよりなる井戸層を25オングストローム、ノン ドープIn0.01Ga0.95Nよりなる障壁層を50オング ストロームの膜厚で成長させて、同じく総膜厚0.1μ mの多重量子井戸構造よりなる活性層5を成長させる他 は、同様にして、共振器長600µmのレーザ素子を得 たところ、活性層に不純物をドープしていないレーザ素 10 子に比較して、閾値電流は60%低下し、出力は35% 向上した。

#### [0043]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のレーザ素 子はその発光スペクトルに、従来のレーザ素子の縦モー ドの発光スペクトルとは全く異なる発光ピークを有する ことにより発光出力が向上する。さらに、活性層中にn 型不純物、p型不純物がドープされていることにより、 発光出力を低下させることなく閾値を低下させることが できる。このため、発光出力が高く閾値の低いレーザ素 20 6・・・第1のp型層 子を実現することができる。また、本発明のレーザ素子 を埋め込みヘテロ型、屈折率導波型、実効屈折率導波型 等の横モードの安定化を図るレーザ素子とすることによ り、さらに閾値電流が下がる可能性がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例に係るレーザ素子の構造を 示す模式断面図。

【図2】 図1のレーザ素子の活性層付近を拡大して示 す模式断面図。

【図3】 本発明のレーザ素子にパルス電流を流した際 の発光スペクトルを各電流値で比較して示す図。

【図4】 活性層にドープしたSi濃度と、レーザ素子 の閾値電流の低下率との関係を示す図。

【図5】 活性層にドープしたMg濃度と、レーザ素子 の閾値電流の低下率との関係を示す図。

【図6】 本発明のレーザ素子の井戸層のエネルギーバ ンド図。

### 【符号の説明】

1 ・・・ 基板

2・・・バッファ層

3・・・n型コンタクト層

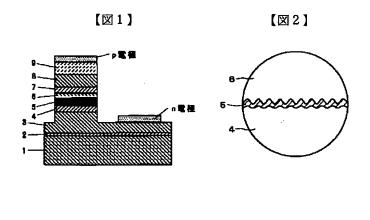
4··・n型クラッド層

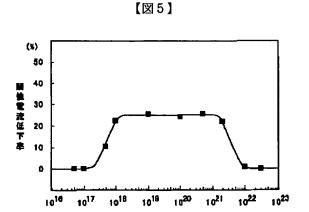
5・・・活性層

7・・・第2のp型層

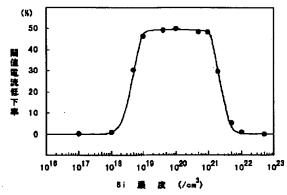
8・・・第3のp型層

9· · · p型コンタクト層

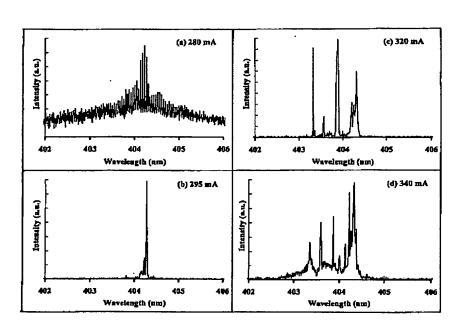












【図6】

